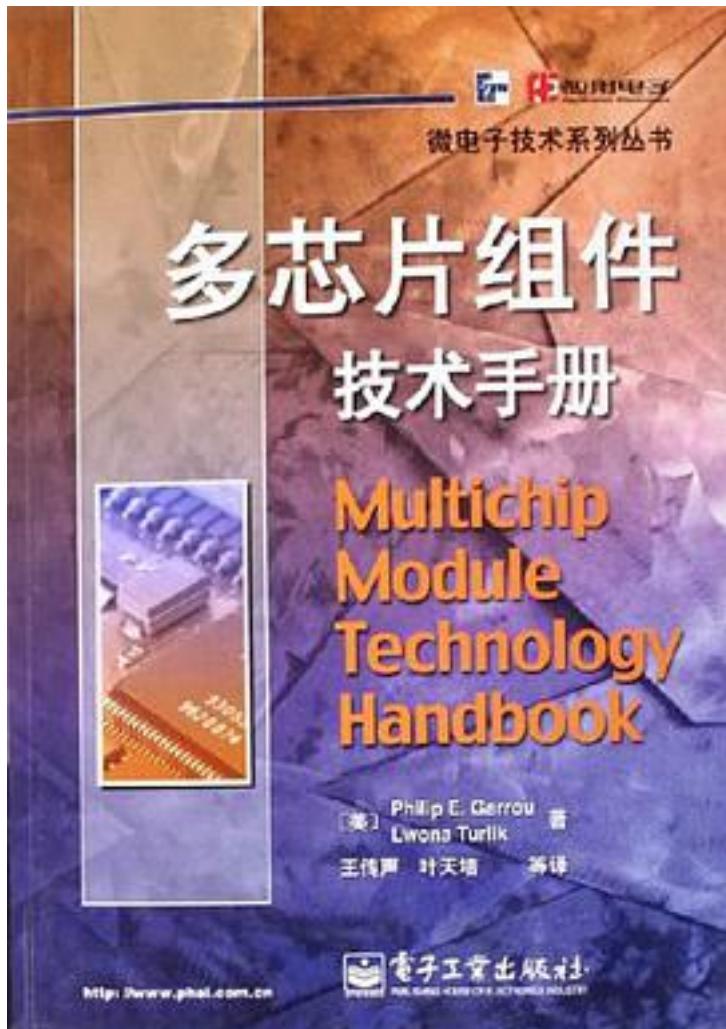


多芯片组件技术手册



[多芯片组件技术手册 下载链接1](#)

著者:盖瑞

出版者:电子工业出版社

出版时间:2006-2

装帧:

isbn:9787121022807

多芯片组件(MCM)技术是当代先进的微电子组装与封装技术。本书从电路设计、材料性

能、工艺装配、封装热设计和测试等方面综合论述了多芯片组件技术及其最新进展情况；并对其技术特性和应用领域进行了深入的研究，包括多芯片组件所涉及的相关领域，如微电子学、物理学、化学和物理化学等交叉学科的详细信息。本书可以作为国内从事混合微电子专业的技术人员的参考书，也可以作为高等院校电子学和微电子相关专业的本科生和研究生的教科书。

第1章讲述了：MCM技术的发展推动力；第2章到第4章评述了MCM-C、MCM-D和MCM-L应用的各种材料和技术方案，列举了一些商业上相关的例子；第5章介绍了大面积加工(LAP)的最新技术，其中的印制电路板(PWB)和平板显示器(FPD)技术用于制造低成本薄膜MCM组件；第6章详细阐述了在要求高度压缩体积系统上应用的3D MCM技术；第7章和第8章论述了MCM封装设计和芯片与组件的装配；而第9章论述了组件与电路板的连接；第10章讲述MCM基板设计；第11章论及MCM电性能；第12章介绍了高性能数字电路电子封装技术；第13章谈到热性能问题；第14章详细阐述了对已知好芯片(KGD)的需求；第15章论述了组件的测试与检验。这些综合起来全面介绍了多芯片封装技术的发展水平。

作者介绍：

目录：

[多芯片组件技术手册 下载链接1](#)

标签

多芯片

评论

[多芯片组件技术手册 下载链接1](#)

书评

[多芯片组件技术手册 下载链接1](#)